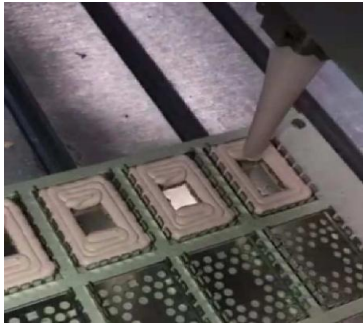




TIF®080 AB-11S 是一种高导热、液态间隙填充材料，具有双组份及不同温度固化时间特点。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，因而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式，提供各种厚度，取代一般导热垫片的模切厚度，且不同于一般硅胶片，此系列产品固化后是干燥可触摸的，故可被更广泛应用。

特性

- 》良好的热传导率：**8.0W/mK**
- 》双组份材料，易于储存
- 》优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算机硬设备
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

TIF®080 AB-11S 系列特性表		
未固化材料特性		
性质	数值	测试方法
A组份颜色	白色	目视
B组份颜色	灰色	目视
挤出量(g/min)@75psi	4.5	-
密度 (g/cm ³)	3.4	ASTM D792
最小界面厚度 (mm)	0.2	ASTM D374
混合比例	1:1	-
保质期期限25°C	6个月	-
固化条件		
操作时间25°C	30分钟	-
固化时间25°C	120分钟	-
固化时间70°C	30分钟	-
固化后材料性能		
颜色	灰色	目视
硬度 (Shore OO)	45	ASTM D2240
建议工作温度	-45 ~ 200°C	-
击穿电压 (V/mm)	≥4000	ASTM D149
体积电阻率 (Ohm-cm)	> 1.0X10 ¹²	ASTM D257
阻燃等级	V-0	UL 94
导热系数 (W/mK)	8.0	ASTM D5470
热阻抗 @10psi (°C-in ² /W)	0.72	ASTM D5470
热阻抗 @50psi (°C-in ² /W)	0.60	ASTM D5470

产品型号说明:

TIF 080AB - 11S

颜色: 11 (灰色) / 硬度: 45

AB: A组份/B组份

导热率: 8.0 W/mK

产品型号

产品规格

50 cc/支, 48 支/箱; 400 cc/支, 9 支/箱

或在注射器用于自动化应用定制包装。 如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。



导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada
TEL: +001-604-2998559
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.thermazig.com>

台湾 Taiwan
TEL: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞 Dongguan
TEL: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com>

昆山 Kunshan
TEL: +86-512-57816297
E-mail: kelvin@ziitek.com
<http://www.ziitek.com>

长沙 Changsha
TEL: +86-731-86949836
E-mail: jor@ziitek.com
<http://www.ziitek.com>